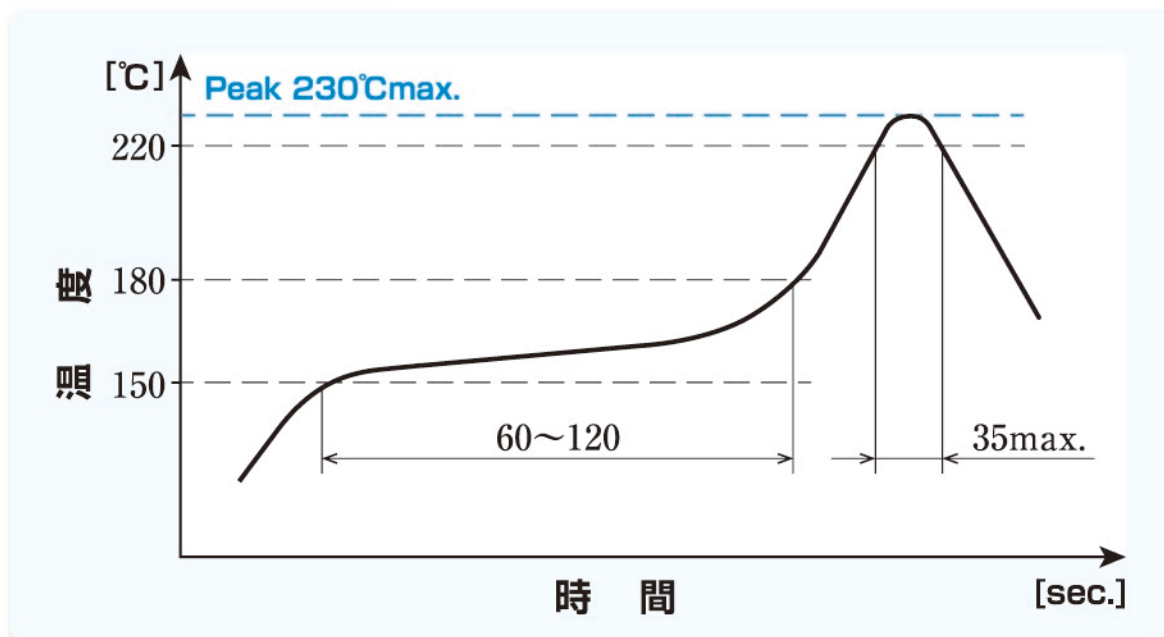


推奨はんだ条件

推奨リフローはんだ条件



【注意事項】

プロファイルは、製品の最高温度部分における値です。
はんだの“流れ”を確実にするために、はんだペーストの印刷厚は0.15mm以上を推奨いたします。
端子先端部(切断面)は、端子素地が露出しているため、はんだ濡れ性の保証対象外といたします。
本プロファイルは、あくまでも推奨条件値であり、実工程にて問題の有無をご確認後にご使用ください。

【保管条件・防湿レベル】

カタログ記載製品の防湿レベル(MSL)Level3について、防湿梱包開封後は、高温・多湿の保管を避け、防湿庫に保管してください。開封後、Floor Life(168h)を越えてからご使用になられる場合は、吸湿による外装クラックの発生を防止するため、ベーキング処理などを行ってからご使用ください。

推奨はんだ付け条件

●ディップはんだ付け条件

工程	条件
予備加熱	100°C ~ 150°C
はんだディップ温度	ピーク 260°C Max. 10秒以下
冷却	100°C以下までの自然冷却

但し、製品本体部分をはんだ槽へ浸漬させることは不可

●手付けはんだ条件

手付けにてはんだ処理をする場合は、以下の条件で作業してください。

コテ先温度	340°C Max.
処理時間(1端子あたり)	3.5秒 Max.

➔ これらに関するお問合せについては、info@jpc-inc.co.jp へご連絡ください。